

2024年3月期 第1四半期決算説明資料

Mipox株式会社(マイボックス) 証券コード 5381

2023年8月10日

01 業績概要	-----	2024年3月期 第1四半期
02 業績見通し	-----	2024年3月期 通期
03 Appendix	-----	会社概要

01

業績概要

2024年3月期 第1四半期

2023年4月1日～2023年6月30日

2024年3月期 第1四半期 業績サマリー

主要な顧客マーケットである、ハードディスクやエレクトロニクス製品、半導体市場の需要減退により、売上高が減少し、各段階利益は損失計上となりました。

売上高

1,867 (百万円)

前年同期比較 [Q1累計]

959百万円 **減少** (-33.0%)

営業利益(損失)

-336 (百万円)

前年同期比較 [Q1累計]

398百万円 **減少** (- %)

経常利益(損失)

-231 (百万円)

前年同期比較 [Q1累計]

562百万円 **減少** (- %)

純利益(損失)

親会社株主に帰属

-175 (百万円)

前年同期比較 (Q1累計)

468百万円 **減少** (- %)

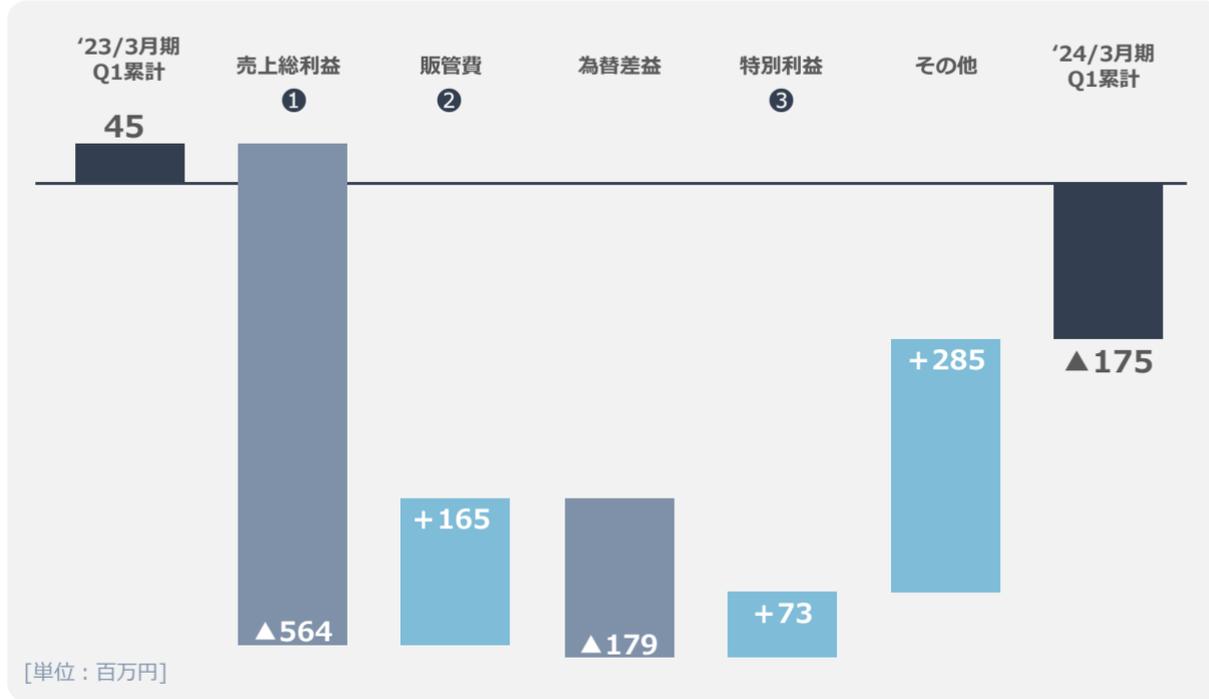
業績概要

2023年3月期 下期同様にハードディスク、エレクトロニクス製品、半導体関連市場が低迷しております。これら市場はハイテク関連製品の主な顧客マーケットであり、大きく影響を受け、減収減益となりました。

減益要因

売上高が対前年同期比で33.9%減少した結果、営業損失、経常損失、純損失を計上しております。

対前年同期比では、売上高の減少に伴い、売上総利益が減少しました。販管費の抑制や中国子会社の清算益等がありましたが、175百万円の純損失で着地しました。



利益減少要因

- ① ハイテク関連製品を中心とした売上高の減少により、売上総利益が564百万円減少しました。
- ② 運送費等の変動費の減少を主な要因として、販管費が減少しました。
- ③ 2020年3月に清算決議をした中国子会社の清算手続きが完了し、清算益を特別利益に計上しております。

※増減算出後百万未満切捨て

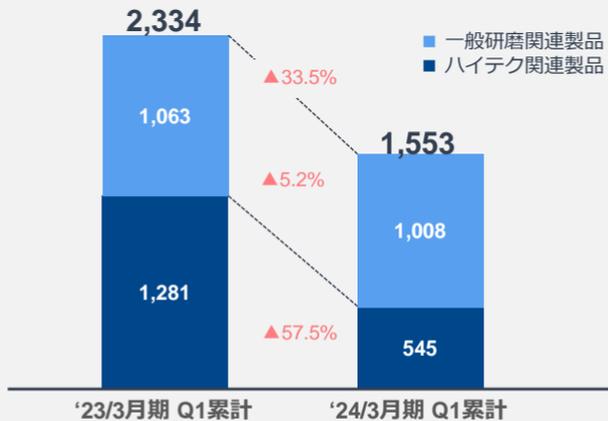
製品事業の売上高は対前年同期比で33.5%減少となりました。
ハイテク関連が57.5%減少し、一般研磨関連は5.2%の減少に留まりました。売上高減少の影響が大きく、158百万円のセグメント損失を計上しました。

製品事業

ハイテク関連製品 / 一般研磨関連製品

売上

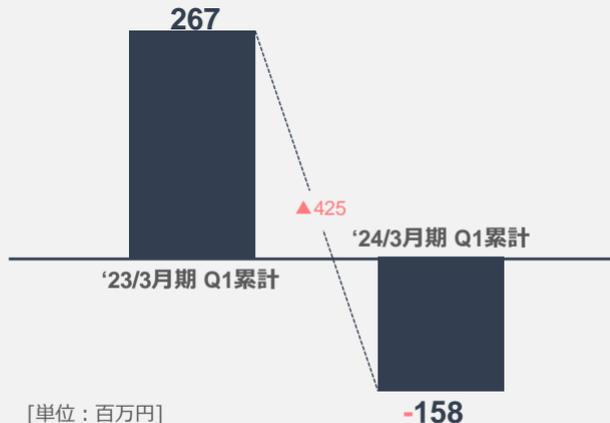
前年同期比較



[単位：百万円]

セグメント営業利益 (損失)

前年同期比較



[単位：百万円]

製品事業はハイテク関連製品と一般研磨関連製品に区分されます。両研磨製品共に売上高は減少となり、特にハイテク関連が大きく減少しました。売上高の減少に伴い、セグメント営業損失158百万円を計上しました。

ハイテク関連製品

ハードディスク、光ファイバー、半導体関連の主な用途の全てにおいて売上高が減少しました。

一般研磨関連製品

自動車関連や鉄鋼関連向けの売上高が減少しました。

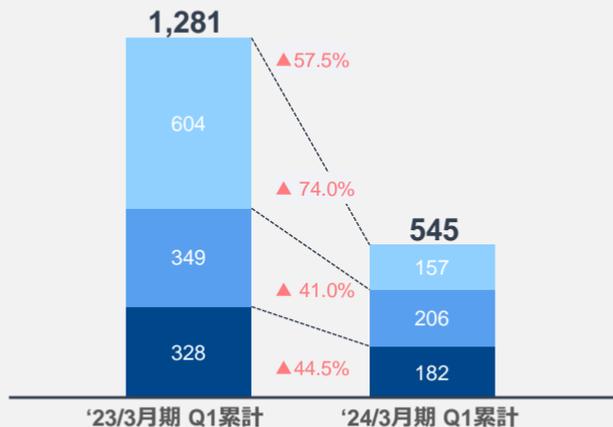
※増減算出後百万未満切捨て

製品事業内訳

用途別売上

ハイテク関連製品

■ HDD関連 ■ 光ファイバー関連 ■ 半導体関連



[単位：百万円]

HDD・光ファイバー関連 データセンター向け投資の抑制が継続しています。対象用途であるコネクタの製造やハードディスクの需要減少で売上高が減少しています。

半導体関連 エレクトロニクス製品の需要不振の影響もあり半導体製品全般で売上高が74.0%減収しました。

一般研磨関連製品

■ 自動車関連 ■ 鉄鋼関連 ■ その他

家具、楽器、船、建機、電子デバイス関連、反射材等



[単位：百万円]

自動車関連 日本国内の半導体不足の影響による生産抑制は限定的になりつつも、海外向けを中心に当社製品の売上高が減少しました。

鉄鋼関連 半導体の製造装置に係る金属加工需要や中国の建設需要減退により海外向けを中心に売上高が減少しました。

※増減算出後百万未満切捨て

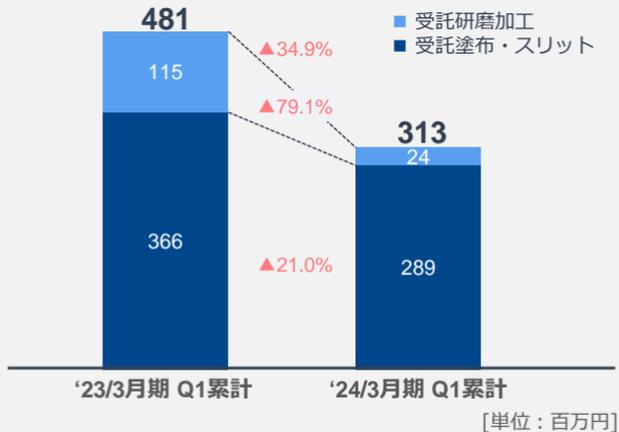
エレクトロニクス製品の需要低迷が続いており、受託塗布・スリットおよび受託研磨加工の両サービスで減収し、セグメント営業損失が継続しています。

受託事業 (エンジニアリング事業)

受託塗布・スリット (エンジニアリングサービス) / 受託研磨加工 (ウェーブプロセッシング)

売上

前年同期比較



セグメント営業利益 (損失)

前年同期比較



受託事業は受託塗布・スリットと受託研磨加工に大別されます。両サービス共に売上高は減少し、前期同様にセグメント損失を計上しています。

受託塗布・スリット

PCやタブレット、スマートフォン等のエレクトロニクス製品の需要動向に影響を受け、売上高は21.0%の減収となりました。

受託研磨加工

半導体市場の低迷に加え、海外のスマートフォン市場の縮小の影響により関連部品の研磨加工の需要量が減少し、売上高は79.1%の減収となりました。

売上高の減少により運転資本が減少し、総資産は減少しました。

[単位：百万円]	2023年3月末	2023年6月末	※増減算出後百万未満切捨て 増減
流動資産	9,032	8,778	▲ 254
現金及び預金	2,613	2,388	▲ 225
売上債権※	2,385	2,092	▲ 293
棚卸資産	3,127	3,258	131
その他	908	1,039	131
固定資産	7,162	7,207	45
有形固定資産	6,663	6,675	12
資産合計	16,195	15,986	▲ 209
流動負債	5,065	5,459	394
支払手形及び買掛金	793	698	▲ 95
短期借入金（社債含む）	2,930	3,740	810
未払金	664	409	▲ 255
その他	376	230	▲ 146
固定負債	3,131	2,867	▲ 264
長期借入金（社債含む）	2,867	2,624	▲ 243
負債合計	8,197	8,326	129
純資産合計	7,997	7,659	▲ 338
負債純資産合計	16,195	15,986	▲ 209

2024年3月期第1四半期

総資産

15,986

(百万円)

純資産

7,695

(百万円)

自己資本比率

47.9%

※売上債権は受取手形、売掛金、電子記録債権を合計し、棚卸資産は商品および製品、仕掛品、原材料及び貯蔵品を合計しております。

02

業績見通し

2024年3月期 通期

ハイテク関連製品は下半期での回復を見込んでいます。半導体関連向け新製品の販売やインドでの新商材の展開等を進めていきます。

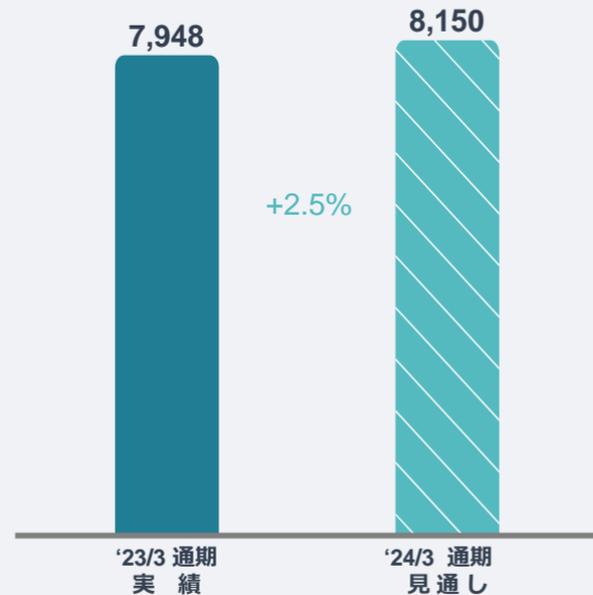
ハイテク関連製品

- 2024年3月期上半期は想定の通り主な顧客用途であるハードディスク関連、光ファイバー関連、半導体関連の全てで苦戦しています。これら用途向け売上高は下半期での回復を見込んでいます。
- 半導体関連向け新製品であるプローブカードの耐熱性クリーニングシートの販売を開始します。

一般研磨関連製品

- 市場の拡大が続くインドに新工場を設立予定です。活発な建設需要を取込む鉄鋼・橋梁向け研磨製品の販売を新たに開始予定です。
- 2023年3月に取得した溶剤フリーのIH粉体塗装事業の営業展開と一般研磨関連製品への技術転用の研究を開始します。
- 2022年に子会社化したミスミ化学の製造機能の統合を完了しました。共同開発の新製品の販売を開始します。

[単位：百万円]



ハイテク関連製品同様に下半期での回復を見込んでいます。受託先の新規獲得が進んでおり、安定した受託量の増加を目指します。

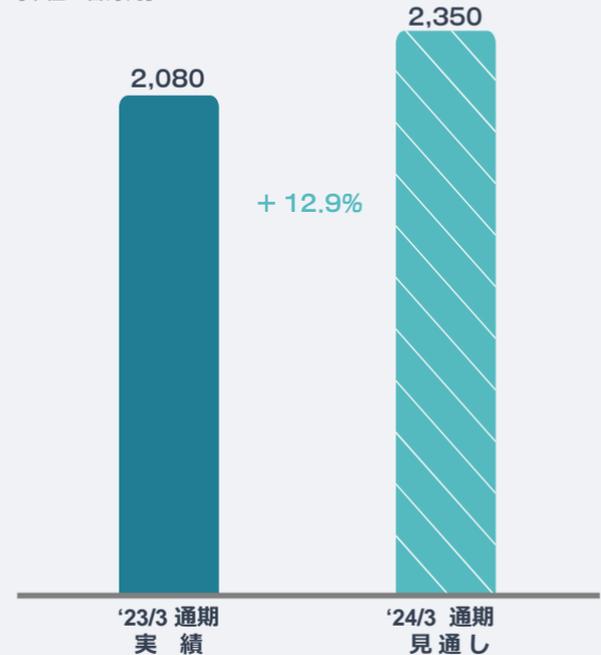
受託塗布・スリット（エンジニアリングサービス）

- 鹿沼事業所、北杜事業所の生産体制構築完了につき、稼働率の向上に努めます。
- 北杜・鹿沼事業所の技術連携により、機械や人員、生産の稼働率を最大限に引き出し売上拡大を目指します。

受託研磨（ウェーハプロセッシング）

- 次世代半導体に向けた専用の研磨装置や研磨材（スラリー・研磨フィルム）の開発に取り組みます。
- 研磨加工機、洗浄機の追加により生産能力を増強し、新しいアプリケーション対応に取り組みます。
- 常温接合のアプリケーション拡充の取組みを進めます。

[単位：百万円]



免責事項及び将来の見通しに関する注意事項

当社および当社グループの各部門に関する業界の動向についての見直しを含む、国内および諸外国の経済状況、ならびに為替レートの変動その他の業績に影響を与える要因について、現時点で入手可能な情報をもとにした予測を前提としており、実際の業績等はこの資料に記載されている将来の見通しとは大きく異なる可能性があることをご留意ください

03

Appendix

会社概要

会 社 名 Mipox(マイポックス)株式会社

英 文 名 Mipox Corporation

創 業 大正14年(1925)年11月21日

設 立 昭和16年(1941)年12月12日

代表取締役社長 渡邊 淳 (Jun Watanabe)

本店・本社 〒322-0014 栃木県鹿沼市さつき町18

株式市場名 東京証券取引所 スタンダード

証券コード 5381



Ref Lite
Color Your Style.



スガ コーディングス

Mipox(マイボックス)の名前の由来

ミクロの研磨を表す「Micro Polish」・鏡面の威力を表す「Mirror Power」双方の頭文字と、無限の可能性を秘めた「X」を添えて「Mipox」となったのが由来です。

ミクロの研磨
MICRO POLISH

鏡面の威力
MIRROR POWER

無限の可能性を秘めた

X

1925

独逸顔料合名会社



1981

日本マイクロコーティング (株)

製品ブランド「MIPOX」 **MIPOX**



今日、4月1日より社名変更 旧社名 独逸顔料工業株式会社
コーティング・機能コーティング技術を開発する
日本マイクロコーティング株式会社
コーティング・機能コーティング技術を開発する
日本マイクロコーティング株式会社

2013

Mipox株式会社

mipox

『塗る・切る・磨くで世界を変える』

我々は1925年の創業以来、メーカーとして培ってきた当社のコア技術である

「塗る・切る・磨く」と共に発展してまいりました。

この「塗る・切る・磨く」を通して、世界の変化を支えることが我々が果たすべき役割であり存在意義であります。

経営方針

エンジニアリングアプローチによる製品事業の付加価値向上

受託事業からエンジニアリングサービス事業への転換

早い変化と多様性に対応できる経営基盤の整備

「塗る、切る、磨く、観る」を極めた技術力

創業から続く箔の製造技術を応用することで「塗る」「切る」「磨く」技術をコアにした事業を展開した企業であり、最近では、当社の研磨品質が“市場に検査できる装置がない”というレベルにまで達し、検査装置の拡充も後押しし、現在は「観る」技術もコア技術に加えた「塗る、切る、磨く、観る」をコア技術としています。



Mipoxでは、自社製品の製造のみならず、受託事業も手がけております。
 研磨業界において、世界シェアを誇る分野をもつニッチトップコンバーターです。

製品事業

一般研磨関連製品
 ハイテク関連製品

研磨材を開発・製造して、販売をしています。
 超精密研磨から一般研磨、装置や反射材など、世界中の幅広い用途で当社製品を提供しています。



研磨フィルム



液体研磨剤



研磨関連製品



研磨布紙製品



研磨砥石製品



研磨周辺機器



検査装置



再帰性反射材
(Ref Lite)



ヤスリ製品



IH粉体塗装

受託事業

受託研磨加工
 受託塗布・スリット

受託研磨は、主に半導体用途を中心に、ウェーハをはじめとする材料をお客様よりお預かりし、弊社が保有する設備（研磨装置、洗浄機、検査装置）と弊社独自の研磨材を用いて、お客様の要望に沿った研磨加工を提供。受託コーティング・スリットは、お客様の基材(フィルム等)や塗料材をお預かりし、弊社が保有する設備（調合、コーティング、スリット）を用いてフィルム化。



塗布製品



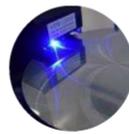
研磨加工



スリット加工



常温接合加工



検査

IRお問い合わせ

<https://www.mipox.co.jp/inquiry.html>



フェアディスクロージャーの観点から、公平な情報開示体制と株主様と投資家の皆様へのお問合せ対応の維持を考慮し、IRお問い合わせ窓口のお電話での対応をおこなっておりません。HPのお問い合わせフォームをご利用ください。

